

5120732-1 ✓ AKTIV

Z-PACK | Z-PACK HS3

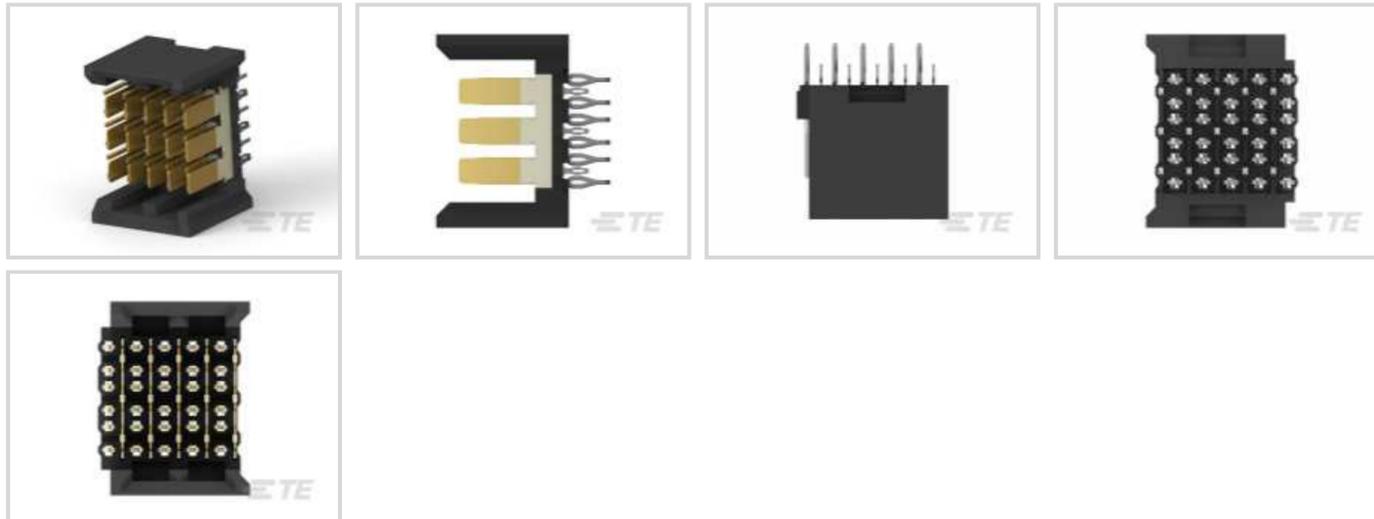
Interne TE-Nummer 5120732-1

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 30 Position,
Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, 6 Row, 5
Column, Z-PACK HS3

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **30**

Reihenabstand: **2 mm [.078 in]**

Gegensteckführung: **Mit**

Typ der Gegensteckführung: **Polarisierung**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Backplane-Modultyp	Mitte
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Nein
Anzahl von Positionen	30
Zeilenanzahl	6
Spaltenanzahl	5
Backplane-Architektur	Herkömmliche Bus-Leiterplatine (Rückseite)
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	250 VAC
-----------------	---------

Signalmerkmale

Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte	3
---	---

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	6.8 mm[.268 in]
Kontakttyp	Stift
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.5 µm[19.68 µin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Kontakt-nennstrom (max.)	1.15 A

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	3.7 mm[.146 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

Führungskomponenten	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Anzahl der gehüllten Seiten	Zweiseitig
Gehäusematerial	Polyester – GF
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	2.5 mm[.098 in]

Abmessungen

Steckverbinderlänge	12.41 mm[.489 in][.945 in]
---------------------	----------------------------

Steckverbinderhöhe	11.8 mm[.47 in]
Steckverbinderbreite	24 mm
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.4 mm
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	.05 mm[.001 in]
Reihenabstand	2 mm[.078 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tube
--------------------	------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

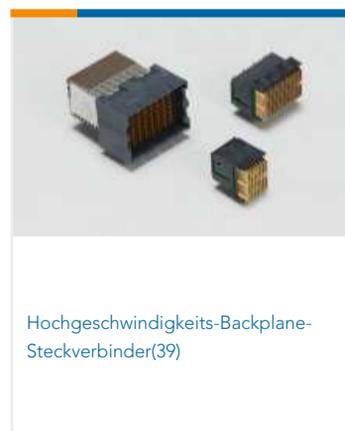
Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | Z-PACK HS3



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

Z-PACK HS3 HDR ASSY 6R 30P

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5120732-1_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5120732-1_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5120732-1_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch